

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 10 月 21 日 (21.10.2004)

PCT

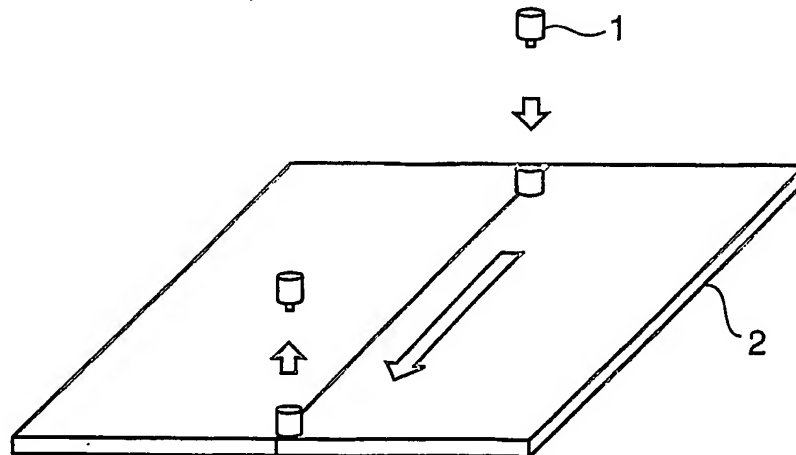
(10) 国際公開番号
WO 2004/090194 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C23C 14/34, B23K 20/12 (74) 代理人: 小谷 悦司, 外 (KOTANI, Etsuji et al.); 〒5300005 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番2号 ニチメンビル2階 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/003864
- (22) 国際出願日: 2004 年 3 月 22 日 (22.03.2004) (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-100782 2003 年 4 月 3 日 (03.04.2003) JP (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社コベルコ科研 (KOBELCO RESEARCH INSTITUTE, INC.) [JP/JP]; 〒6510073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 Hyogo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松村 仁実 (MATSUMURA, Hiromi) [JP/JP]; 〒6768670 兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目3番1号 株式会社神戸製鋼所 高砂製作所内 Hyogo (JP). 米田 陽一郎 (YONEDA, Yoichiro) [JP/JP]; 〒6768670 兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目3番1号 株式会社神戸製鋼所 高砂製作所内 Hyogo (JP).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: SPUTTERING TARGET AND METHOD FOR PREPARATION THEREOF

(54) 発明の名称: スパッタリングターゲットおよびその製造方法



(57) Abstract: A sputtering target having been prepared by the butt joining of metal sheets having the same quality, characterized in that an intermetallic compound in a joined portion has an average particle 60 to 130 % that of the intermetallic compound in a non-joined portion. In the sputtering target, the particle diameter of an intermetallic compound in a joined portion is similar to that of the intermetallic compound in a non-joined portion.

(57) 要約: 同質の金属板を突合せ接合して得られるスパッタリングターゲットであって、接合部の金属間化合物の平均粒径が、非接合部の金属間化合物の平均粒径の60~130%と、接合部と非接合部で金属間化合物の粒径がほぼ同程度であるスパッタリングターゲットを提供する。